

Systemy klejenia okładzin ceramicznych i kamiennych

Przewodnik

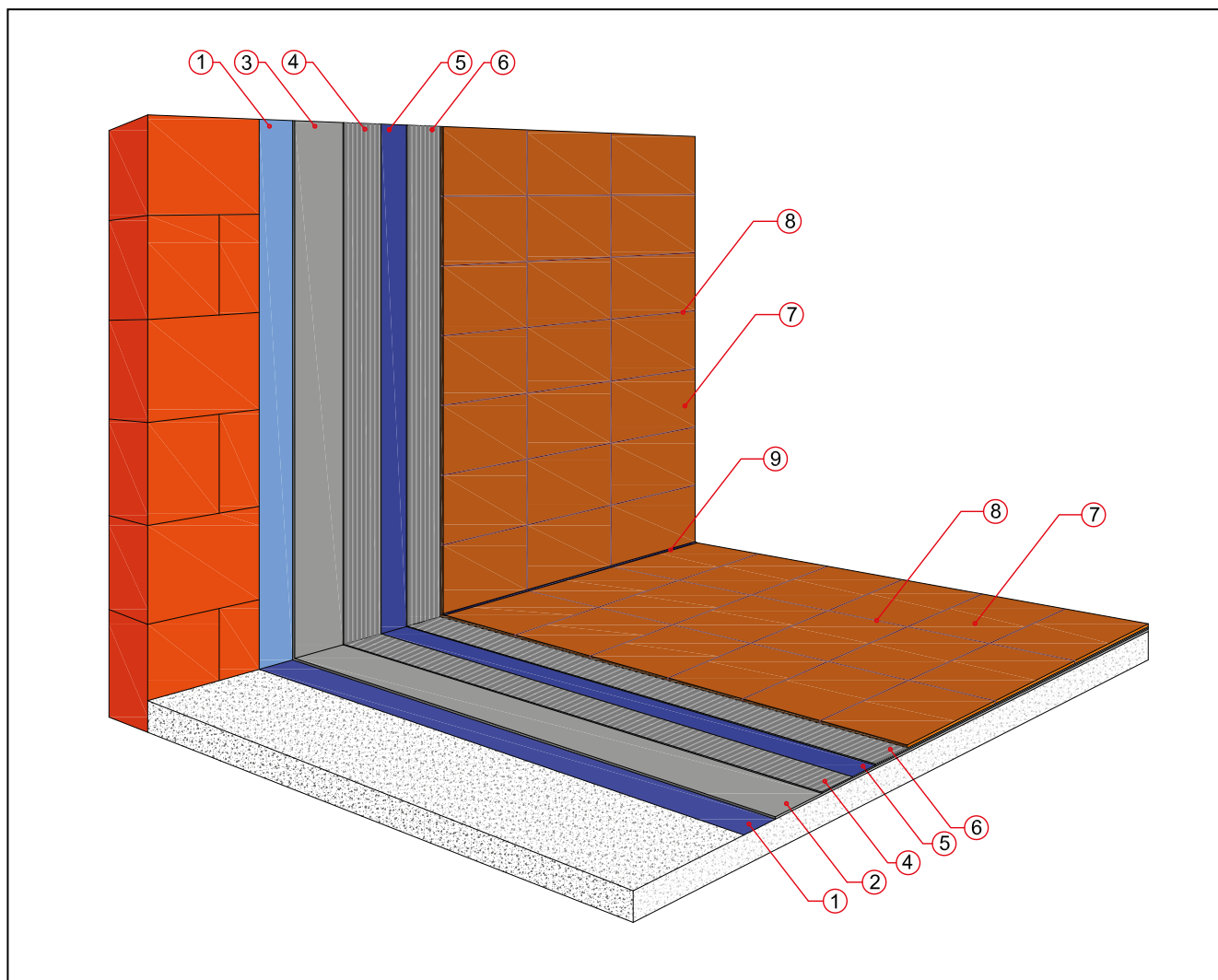


A brand of

BASF

We create chemistry

17. Płytki na paroizolacji



Nr	Elementy systemu	Produkt PCI	Opis produktu
1	Grunt	PCI Gisogrund	Grunt dyspersyjny dom podłoży chłonnych
2	Zaprawa wyrównująca posadzkę	PCI Pericret	szpachlówka cementowa
3	Zaprawa wyrównująca ścianę	PCI Pericret	Szpachlówka cementowa
4	Klej do płytek	PCI Pericol Flex	Elastyczny klej cementowy
5	Paroizolacja	PCI Peilastic W	Arkusz parouszczelniający
6	Klej do płytek	PCI Pericol Flex	Elastyczny klej cementowy
		PCI Durapox NT plus	Klej epoksydowy
7	Płytki		
8	Fuga	PCI Durapox NT plus	Fuga epoksydowa
9	Uszczelniacz	PCI Silcofug E	1-składnikowy uszczelniacz silikonowy

Opis obiektu - warunki eksploatacji - obciążenia

Okładziny płytkowe na paroizolacjach występują najczęściej na ścianach i posadzkach w łaźniach parowych, powszechnych obecnie w obiektach SPA, ale niekiedy także w domach jednorodzinnych i mieszkaniach. Głównym obciążeniem jest para wodna, przed którą należy zabezpieczyć warstwy podłoża i konstrukcję obiektu. Intensywność tego oddziaływania zależy od częstotliwości korzystania z obiektu. Łaźnie prywatne wykorzystywane są zazwyczaj sporadycznie (raz na kilka czy kilkanaście dni), publiczne natomiast używane są prawie nieprzerwanie. Dodatkowe obciążenia to woda i ruch pieszcy. Występują tu naprężenia związane ze zmianami temperatury powietrza. Główne obciążenie chemiczne to ługujące działanie wody kondensacyjnej (ze skroplonej pary) na wszelkie materiały mineralne. Dlatego zaleca się stosowanie fug epoksydowych w miejscach cementowych. Dylatacje występują zazwyczaj tylko w narożach ściana/ściana i ściana/posadzka.

Podłoże

Typowymi podłożami są: jastrych cementowy i tynk cementowy. Muszą one być czyste, nośne, pozbawione rys i wykruszeń oraz równe. Posadzki winny posiadać odpowiednie spadki, skierowane do wpustów posadzkowych. W razie konieczności szybkiego wyrównania, można tego dokonać np. szpachlówką cementową **PCI Pericret**, która nadaje się do równania ścian i posadzek. Produkt ten umożliwia kontynuację robót już po kilku godzinach.

Wykonawstwo

A. PAROIZOLACJA

podłoże mineralne środkiem **PCI Gisogrund**, rozcieńczonym wodą zależnie od chłonności podłoża w stosunku 1:1 do 1:2. Przy użyciu elastycznego kleju cementowego **PCI Pericol Flex** przykleić arkusz paro- i wodouszczelniający **PCI Pecilastic W**. Do sklejania zakładów wykorzystać izolację mineralną **PCI Seccoral 2K**.

B. WYKLEJENIE PŁYTEK

Do mocowania okładziny płytkowej należy stosować elastyczny klej cementowy **PCI Pericol Flex**.

C. SPOINOWANIE PŁYTEK

Spoinowanie najlepiej wykonać epoksydową fugą: **PCI Durapox NT plus**. Szerokość fug zależy od rozmiaru płytek i winna być określona przez projektanta w projekcie rozmieszczenia elementów okładziny.

W dylatacjach narożnych ściana/posadzka i ściana/ściana należy wypełnić spoiny uszczelniaczem silikonowym **PCI Silcofug E**.

Uwagi

Wskazane rozwiązanie należy traktować jako przykładowe. Każdorazowo należy je adaptować do konkretnej konstrukcji i warunków eksploatacyjnych, opierając się zasadach wiedzy budowlanej. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z regionalnym Doradcą Technicznym PCI.